



2020第五届IEEE集成电路与微系统国际会议

中国·南京

ICICM 2020

会议简介

第五届集成电路与微系统国际会议将于2020年10月23-25日在南京召开！本次会议由IEEE和IEEE电路与系统协会赞助，电子科技大学微电子与固体电子学会和东南大学联合承办。欢迎广大专家学者踊跃投稿，积极参会！

集成电路在电子信息时代起着至关重要的作用，现已成为中国一级学科。顺应时代的发展和按照习近平总书记重要指示精神-“核心技术、关键技术、国之重器必须立足于自身”，自2016年以来，电子科技大学微电子与固体电子学会、东南大学联合承办集成电路与微系统国际会议。从成都出发，先后在南京，上海，北京举行了前4届会议。而前四届ICICM会议的成功举办也为我们今后的发展奠定了坚实的基础，并给予了我们的信心。

会议出版与历史 接收的文章将收录到IEEE会议论文集，并由CPCI, Ei Compendex 以及Scopus等大型知名数据库检索。

◆ 前四届ICICM会议论文集均已入库IEEE Xplore，并成功被Ei Compendex 和Scopus 检索了。



2019年10月25-27日 中国北京
出版：IEEE会议论文集
ISBN: 978-1-5090-2813-9



2018年11月24-26日 中国上海
出版：IEEE会议论文集
ISBN: 978-1-5386-8310-1



2017年11月8-11日 中国南京
出版：IEEE会议论文集
ISBN: 978-1-5386-3505-6



2016年11月23-25日 中国成都
出版：IEEE会议论文集
ISBN: 978-1-5090-2813-9

会议微信二维码



扫码联系会议助理咨询
会议相关问题

组委会

顾问主席	◆ David Z. Pan	德克萨斯大学奥斯汀分校 (IEEE 院士, SPIE 院士)
	◆ Ljiljana Trajkovic	西蒙弗雷泽大学 (IEEE 院士)
大会主席	◆ Zhigong Wang	东南大学
	◆ Li Qiang	电子科技大学 (IEEE成都SSCS/CASS联合分会创始主席)
程序委员会主席	◆ Fei Yuan	瑞尔森大学 (IET院士)
	◆ Zou Zhuo	复旦大学
	◆ Liu Dake	北京理工大学 瑞典林雪平大学
指导委员会主席	◆ Huang Le Tian	电子科技大学

征稿主题 包括但不限于以下内容

- ◆ THZ和微波微系统
- ◆ 互连、低K、高K等工艺技术
- ◆ 半导体材料与材料特性
- ◆ 无线系统的装置和电路
- ◆ 非常规和纳米电子学
- ◆ 建模与仿真
- ◆ 通信专用电路和系统
- ◆ 有机半导体器件与技术
- ◆ 高级存储技术等
- ◆ 数字、模拟、混合信号IC和SOC设计技术
- ◆ 复合半导体器件与技术
- ◆ 低功率射频设备和电路
- ◆ 硅集成电路与制造
- ◆ 显示器、传感器和MEMS
- ◆ 集成电路计算机辅助设计技术

投稿方式

- ◆ 将文章上传到电子投稿系统<http://www.easychair.org/conferences/?conf=icicm2020>
- ◆ 如果您不能通过投稿系统投稿，请将您的文章发送到会议官方邮箱: icicm@young.ac.cn
- ◆ 听众无需投稿可直接注册，可下载注册表进行注册：http://icicm.net/files/listener_reg.docx

重要日期

投稿截止	2020年9月15日	录取通知	2020年9月30日
注册截止	2020年10月08日	听众注册	2020年10月15日

特别说明

感谢大家对ICICM2020的支持！
因受世界新冠疫情的影响，如后期会前两个月仍然不具备召开线下会议的条件，我们将积极召开线上会议。感谢您的理解！

主办方



协办方



技术支持



会议联系方式

会议助理：曾老师 邮箱：icicm@young.ac.cn 电话：028-87777577(工作时间: 09:30-18:00, 周一至周五)